

2019 年度 技術部 すずかけ台
分析部門・設計工作部門 合同利用説明会のご案内

関係教職員・学生各位

すずかけ台分析部門 部門長／化学生命科学研究所教授 福島 孝典

すずかけ台設計工作部門 部門長 石山 修

すずかけ台分析部門とすずかけ台設計工作部門の 2019 年度利用説明会を下記の通り合同で開催いたします。

説明会では全学共通利用として提供している技術サービスや機器の利用方法・利用上の注意点等について説明いたします。初めて本学に所属される方や機械・装置のご利用を希望、検討されている皆様には、是非参加いただきますようお願いいたします。

設備・機器の詳細は次ページの一覧表をご参照ください。

記

日 時 : 2019 年 5 月 27 日(月) (受付開始 16:45)

- | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. 開会 | 17:00～17:10 | 全体趣旨説明 |
| 2. 利用料金に関する制度変更について(両部門共通事項) | 17:10～17:20 | |
| 3. すずかけ台設計工作部門 | 17:20～17:50 | 概要、工作依頼、セルフユース、加工実例、他 |
| 4. すずかけ台分析部門 | 17:50～18:20 | 機器の概要、利用方法、注意点、他 |
| 5. 質疑応答 | 18:20～18:25 | |
| 6. 閉会 | 18:25～18:30 | |

場 所 : すずかけホール 3 階 多目的ホール

参加方法 : 事前登録の必要はありません。

各部門の Web ページを参照の上、ご自由にご参加ください。

注 意 :

・利用予定のある研究室については教職員を含め最低 1 名はご参加いただきますようお願いいたします。

・説明会では資料の配布を予定していません。

当日の資料につきましては各部門の Web ページよりダウンロードして各自で準備していただきますようお願いいたします。

当日資料のダウンロード開始日は 5 月 20 日(月)を予定しております。

すずかけ台設計工作部門 URL: <http://www.tsd.titech.ac.jp/~seimitsu/>

すずかけ台分析部門 URL: <http://www.tsd.titech.ac.jp/~cama/suzu/suzu2/index.html>

問い合わせ : 分析部門 原、小泉 E-mail : bunseki-s@tsd.titech.ac.jp 内線 : 5278

設計工作部門 古里 E-mail : skc_madoguchi@tsd.titech.ac.jp 内線 : 5071

以上

次ページに設備・機器一覧

すずかけ台分析部門 管理装置一覧	
構造解析装置:	NMR(400/ 500MHz Bruker・400MHz JEOL) ESR(JEOL) 単結晶 X 線回折装置(APEXII, Bruker・XtaLAB Synergy-DW, リガク) SAXS・WAXD(粉末/薄膜X線回折 散乱装置 NANO-Viewer リガク) XRD(粉末X線回折装置 UltimaVI リガク・X線示唆走査熱量同時測定装 XRD-DSC UltimaVI リガク)
有機元素分析装置:	CHNS同時測定装置(VarioEL)、CHN同時測定装置(JM10) ハロゲン・S同時測定装置(HSU-20+ICS-1100) 酸素測定装置(Vario micro cube)、ウルトラマイクロ天びん・マイクロ天びん (ザルトリウス・メトラー)
無機元素分析装置:	ICP発光分光分析装置 (ICP-AES: ICPS-8000, 島津製作所)、 ICP質量分析装置 (ICP-MS: ELAN DRC-e, パーキンエルマー)、 エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (EDX: S2 RANGER, ブルカー)
質量分析装置:	MALDI-TOF-MS (ultrafleXtreme, ブルカー・AXIMA CFR-Plus, 島津製作所)、 ESI-TOF-MS, LC付 (micro TOF II, ブルカー)、BE-MS, GC付 (JMS-700, 日本電子)
熱分析装置:	示差熱-熱量同時測定装置 (TG-DTA: DTG-60, 島津製作所)、 示差熱天びん-光イオン化質量分析同時測定システム (TG-DTA-MS: ThermoMassPhoto, リガク)
顕微鏡関連:	透過電子顕微鏡 (FE-TEM: JEM-2010F/JEM-2100F, 日本電子)、 走査電子顕微鏡 (FE-SEM: S-5500, 日立ハイテック/環境SEM: JSM-6610LA, 日本電子)、 複合ビーム加工装置 (FIB/SEM: JIB-4500, 日本電子)、 原子間力顕微鏡 (AFM: Cypher S, オックスフォードインストルメンツ)、 試料前処理装置 (コーター, イオンミリング等)
その他装置:	超高速液体クロマトグラフシステム (UPLC: AQUITY-PDA, ウォーターズ)、 時間分解吸収分光解析システム (TRASAS, 浜松ホトニクス)、 多角度光散乱検出器システム (MALS・RI・DLS・SEC, Wyatt Technology) 分光エリプソメーター (ELC300, 日本分光)
すずかけ台設計工作部門 管理機械一覧	
マシニングセンタ:	5 軸立型マシニングセンタ (Vertex550-5x, 三井精機)、 3 軸立型マシニングセンタ (V22, 牧野フライス/ α -D14MiB5, ファナック)
ターニングセンタ:	複合加工機 (MULTUS B200 II, オークマ)
放電加工機:	ワイヤ放電加工機 (PX05, 三菱電機/DUO43, 牧野フライス)、 高速細穴放電加工機 (K1C, ソディック)
フライス盤:	NC フライス盤 (KEV-55: AEV-74, 牧野フライス/ R-3VN, 静岡鐵工所/ YZ-8WR, 山崎技研)
旋盤:	CNC 旋盤 (LB-2000EX, オークマ)、対話型NC 旋盤 (TAC360, 滝澤) 汎用旋盤 (LS-540: LS450: LK, オークマ/ 昌運カズヌーブ)、卓上旋盤 (KL-8, 協立/ LB8-4B, 江黒)
研削盤:	平面研削盤 (NP520-F, 長島精工/GHL-B406-4, 日立精工)、円筒研削盤 (GOP10-30, 豊田)
その他:	鋸盤 (バンドソー/コンターマシン)、ボール盤 (卓上ボール盤/ 直立ボール盤/ ラジアルボール盤)、 溶接機 (アーク溶接/ スポット溶接/ TIG 溶接/ MAG 溶接/ 半自動溶接機) 高速切断機 (ラボカッター/ シアーカッター/ ダイヤモンドカッター) グラインダ (卓上両頭グラインダ/ ドリル研磨機/ エンドミル研磨機) マイクロスコープ (VHX-5000, キーエンス)、超精密ナノ加工機 (α -01B, ファナック) アーム型3次元測定器 (ROMER Absolute Arm71, HEXAGON)